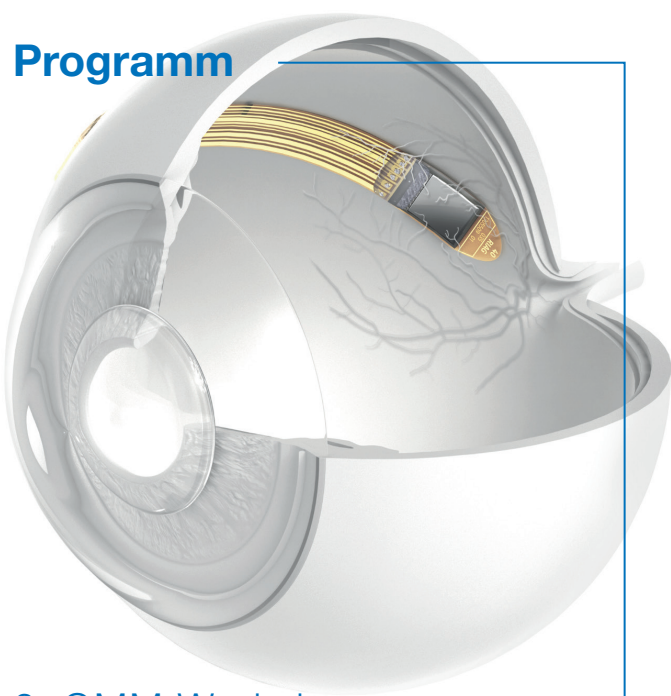


Programm



6. GMM Workshop

Packaging von Mikrosystemen PackMEMS 2019

AVT für medizinische Mikrosysteme
Applikationen, Anforderungen und Technologien

28. – 29. März 2019

Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM, Berlin

www.packmems.de



Fraunhofer
IZM

VDE



GMM

Vorwort

Der Fachausschuss GMM 5.5 „Aufbau- und Verbindungstechnik“ richtet 2019 seinen sechsten Workshop im Rahmen der „PackMEMS“-Veranstaltungsreihe aus. In 2019 liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Packaging von Mikrosystemen für medizinische Anwendungen“.

Mikrosysteme finden sich in sehr unterschiedlichen Einsatzfeldern der Medizintechnik wieder. Sie reichen von der Diagnostik, Therapie, Logistik, Telemedizin bis hin zum Ambient Assisted Living. Einige Anwendungsbereiche bedingen sehr spezielle Anforderungen an die Aufbau- und Verbindungstechnik. So benötigen z.B. Implantate geeignete Schnittstellen zum Körper, und die Schaltungsträger müssen an den begrenzten, flexiblen und feuchten „Bauraum“ des menschlichen Körpers anpassungsfähig sein. Auch außerhalb des Körpers sind spezielle Anforderungen in der AV-Technologie umzusetzen. Diese Besonderheiten und Herausforderungen sowie dafür gefundene, beispielhafte Lösungen stehen im Fokus des diesjährigen Workshops.

Das Programm deckt dabei Beiträge aus der Forschung und aus der Industrie ab und gibt so einen Überblick über die vielfältigen Herausforderungen und Möglichkeiten dieses für die AVT immer wichtiger werdenden Einsatzbereiches.

Der Workshop richtet sich an Ingenieure aus Forschung, Entwicklung, Industrial Engineering oder Produktion kleiner elektronischer Systeme und speziell deren Aufbau- und Verbindungstechniken. Die Veranstaltung soll einen fachlichen Austausch sowie nützliche Vernetzung ermöglichen. Aber auch Funktionsentwickler könnten von dem zu vermittelnden Know-how stark profitieren.

Das nachfolgende Workshop-Programm deckt die vom Fachausschusses GMM 5.5 „Aufbau- und Verbindungstechnik“ identifizierten Kernthemen ab. Wir freuen uns, Ihnen eine Gruppe erstklassiger, hoch kompetenter Referenten präsentieren zu können und laden Sie herzlich nach Berlin ein.

Dr.-Ing. Olaf Wittler
Vorsitzender des FA 5.5

Prof. Dr.- Ing. Jürgen Wilde
Stv. Vorsitzender

Veranstalter und Organisation

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und
Feinwerktechnik (GMM)
Dr.-Ing. Ronald Schnabel
Stresemannallee 15
60596 Frankfurt am Main

Tel.: 069-6308 - 227
Fax: 069-6308 - 9828
E-Mail: gmm@vde.com

Tagungsort

Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, IZM
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin
Tel.: 030-46403 - 0

Ansprechpartner vor Ort

Dr.-Ing. Olaf Wittler
Head of Department Environmental and
Reliability Engineering
E-Mail: olaf.wittler@izm.fraunhofer.de

Programmkomitee

Mitglieder des GMM-Fachausschusses 5.5 „Aufbau- und Verbindungstechnik“

O. Wittler	Fraunhofer IZM, Berlin (Vorsitzender)
J. Wilde	IMTEK, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (stv. Vorsitzender)
A. Berns	VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin
K.-H. Bock	TU Dresden, IAVT
M. Detert	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
W. Eberhardt	Hahn-Schickard, Stuttgart
M. Geiger	Binder Elektronik GmbH, Waldstetten
J. Goßler	Micro Systems Engineering GmbH, Berg
M. Hoffmann	Ruhr-Universität Bochum
E. Jung	Fraunhofer IZM, Berlin
S. Klengel	Fraunhofer IMWS, Halle
H. Knoll	Sensitec GmbH, Lahnau
J. Kostelnik	Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Röt am See
G. Kowalski	Unternehmensconsulting, Hamburg
J. Ludewig	viimagic GmbH, Dresden
S. Nieland	CiS GmbH, Erfurt
M. Oppermann	HENSOLDT Sensors GmbH, Ulm
S. Raukopf	Continental Teves AG & Co. oHG, Frankfurt am Main
B. Schmidt	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
V. Tiederle	RELNETyX Consulting UG, Leinfelden- Echterdingen
H. Wohlrabe	TU Dresden
J. Zapf	Siemens AG, München
A. Zimmermann	Hahn-Schickard, Stuttgart

8:30 **Registrierung**

9:00 **Begrüßung**

Implantate

9:15 **AVT-Lösungen für aktive Netzhautimplantate**
Anna Drzyzga, Retina Implant AG, Reutlingen

9:40 **Ansätze für hochkanalige Starr-Flex-Verbindungen in neurotechnischen Implantaten**
Thomas Stieglitz, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Technologien und Schaltungsträger

10:05 **Roadmap der europäischen Leiterplatten Technologie und die wichtigsten Zukunftstrends**
Ralph Fiehler/Achim Süß, KSG GmbH, Gornsdorf

10:30 **Kaffeepause**

11:00 **Flexible und dehnbare Elektronik für Medizinprodukte**
Christine Kallmayer, Fraunhofer IZM, Berlin

11:25 **Räumliche Schaltungsträger und folienbasierte Systeme für die Medizintechnik**
Maximilian Barth, Hahn-Schickard, Stuttgart

11:50 **Technologien der Aufbau- und Verbindungstechnik für telemedizinische Anwendungen**
Martin Schubert, IAVT, Technische Universität Dresden

12:15 **Mittagspause**

Diagnosesysteme

13:15 **AVT in Sensoren für die Computer Tomographie – Trends in Technologie und Entwicklung**
Jan Wrege Siemens Healthineers, Diagnostic Imaging, Forchheim

13:40 **Herausforderungen und Lösungsansätze an die AVT für magnetoresistive Sensoren in medizintechnischen Anwendungen**
Heiko Knoll, Sensitec GmbH, Lahnau

14:05 **Personalisierte miniaturisierte Medizintechnik im Anwendungsfeld der Kathetertechnologien**
David Wagner, tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH, Cluster Medizintechnik Sachsen-Anhalt

14:30 **Kaffeepause**

Optische Technologien

15:00 **UV-LED basierte Strahler für Medizin und Desinfektion**
Moshe Weizman, osa opto light GmbH, Berlin

15:25 **Neue low-cost Technologien und Komponenten für einen Mikrosensor zur Glukosemessung**
Hans-Joachim Freitag, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt

15:50 **Keramische Mikro-Plasmaquelle für die antimikrobielle Behandlung von Oberflächen und Geweben in der Dermatologie**
Michael Fischer, Institut für Mikro- und Nano-Elektronik, Technische Universität Ilmenau

16:15 **Zusammenfassung und Schlusswort**
Olaf Wittler, Fraunhofer IZM Berlin

16:30 **Ende der Veranstaltung**

Allgemeine Hinweise

Tagungsorganisation (Anmeldung)

Bei Fragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an:

VDE-Konferenz Service

Frau Hatice Altintas

Stresemannallee 15

60596 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 6308 - 477

Telefax: 069 / 6308 - 144

E-mail: vde-conferences@vde.com

URL: www.vde.com

Anmeldung

Die Anmeldung zum Workshop „Packaging von Mikrosystemen“ erfolgt über den VDE-Konferenz Service. Das entsprechende Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage der Veranstaltung. Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen und erst nach vollständiger Bezahlung des Tagungsbeitrags.

Teilnahmegebühren

	Anmeldung bis zum 25.02.2019	Anmeldung nach dem 25.02.2019
Teilnehmer	€ 210,00	€ 270,00
Vortragender	€ 0,00	€ 0,00

Bezahlung der Teilnahmegebühr

Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr erst nach Erhalt der Anmeldebestätigung auf das angegebene Konto. Bei der Überweisung sind unbedingt der Name des Teilnehmers und die Rechnungs-Nr. anzugeben.

Stornierung

Bei Stornierung bis zum 25.02.2019 wird die Teilnahmegebühr abzüglich € 50,- für Bearbeitungskosten zurückerstattet; bei Stornierung nach diesem Zeitpunkt kann eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr nicht mehr vorgenommen werden. Es ist jedoch möglich, einen Ersatzteilnehmer zu benennen.

Registrierung

Sie erhalten Ihren Tagungsausweis und Ihre Tagungsunterlagen zu den Öffnungszeiten des Tagungsbüros im Fraunhofer IZM in Berlin.

Telefonische Erreichbarkeit während der Tagung

Am 29. März 2019 befindet sich das Tagungsbüro im Fraunhofer IZM in Berlin. Das Tagungsbüro erreichen Sie dann unter Telefon: 0171 / 46 95 118 (Dr. R. Schnabel).

Allgemeine Hinweise

Veranstaltungsort

Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration, IZM
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin
Tel.: 030-46403 - 0



Abendveranstaltung

Die am Vorabend Anreisenden treffen sich am
28. März 2019 bei

Berliner Unterwelt e.V
Tour Dunkle Welten
Brunnenstraße 105
13355 Berlin
U-Bahnhof Gesundbrunnen

Treff: 17:45 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden

anschließend:
Restaurant Lichtburg
Behmstraße 9
13357 Berlin

VDE



GMM